**經濟部工業局智造設計服務團參團申請須知**

為建構智慧物聯產業之少量多樣的產製環境，奠定軟硬整合發展基礎，並透過專家資源之導入，以提升創新產品之可量產程度。經濟部工業局成立「智造設計服務團」，透過集結國內產品設計服務能量，協助軟硬整合產品/服務推動、開創商機，搭配輔導與媒合機制，彌補產品開發階段之機構/外型設計之缺口，以加速軟硬整合產品達到可量產程度之進程，進而推動產品正式進入小量生產之階段。

有關「智造設計服務團」之申請、審查及輔導推動等相關行政作業，由經濟部工業局委託財團法人資訊工業策進會協助辦理。

主辦單位：經濟部工業局

執行單位：財團法人資訊工業策進會

1. **申請資格**（至少符合一項）
2. 依法辦理公司登記或商業登記之獨資、合夥事業或公司。
3. 如為個人申請者，需具備設計相關學習背景，且擁有產品設計之專案執行經驗。
4. 曾獲國內外產品設計相關之獎項。
5. **參團效益**
6. 擴散媒合：參與工業局之產業推動與商洽媒合。
7. 專業整合：參與法人或廠商之專案合作，組成跨界專業團隊，完成跨領域專業技術組合。
8. 資源轉介：鏈結創新產業，促成業務合作，衍生新型態業務開發。
9. 協同推廣：聯結跨界產學研單位，促成服務整合行銷。
10. **申請資料**
11. 公司/個人簡介與產品設計服務說明表(附件1)
12. 智造設計服務團參團同意書。(附件2)
13. 蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書(附件3)
14. 智造設計服務團保密切結書(附件4)
15. 其他，得自行附加其他佐證資料
16. **申請程序**
17. 申請企業/個人於申請受理期間內，可於網址(<http://www.ideas-hatch.com/service_group.jsp> )線上申請，或下載相關資料填妥並回寄予執行單位。
18. 由執行單位針對資料完整性、申請企業之專業領域進行資格審查。
19. 採線上申請企業如審查通過，請填妥申請資料之【附件3-智造設計服務團參團同意書】回寄紙本文件予執行單位。
20. 符合資格之申請企業，由執行單位通知審查結果，得優先參與執行單位所籌辦之相關產業活動與業務媒合。
21. **收件日期**

108年度申請期間：即日起~108/10/31。於108/10/31後申請之業者，將以參與明年度相關產業活動/業務媒合為主。

1. **收件地點與諮詢服務**
2. 收件地點：財團法人資訊工業策進會 數位服務創新研究所
（台北市松山區民生東路4段133號8樓）
3. 服務窗口：財團法人資訊工業策進會 數位服務創新研究所
 電話：02-6607--2548，林小姐
4. 收件時間認定：
5. 線上申請：以系統記錄之送出申請時間為準。
6. 郵寄方式：以郵務單位郵戳時間為準。
7. 親送：以執行單位收件時間為準。
8. **其他資訊**
9. 申請資格經審查不符合者，不予受理。
10. 檢送之相關申請文件，無論是否通過審查，均不予退還。

**附件1：公司/個人簡介與產品設計服務說明表**

|  |
| --- |
| 申請日期：　　　年　　月　　日 |
| 基本資料 |
| 公司名稱 | (公司填寫) | 統一編號 | (公司填寫) |
| 姓名 | (個人申請者填寫) |  |  |
| 地址 | 　　　　縣　　　　鄉鎮　　 　　街　 　　段　 　　號　　　　市　　　　市區　　 　　路　　 　弄　　 　樓 |
| 負責人 | □先生　□小姐 | 職稱 | 聯絡電話 | ( ) |
|  | E-Mail |  |
| 聯絡人 | □聯絡人同負責人 |
| □先生　□小姐 | 職稱 | 聯絡電話 | ( ) |
|  | E-Mail |  |
| 資本額 | (公司填寫)仟元 | 營業額(去年) | (公司填寫)仟元 | 員工人數 | (公司填寫)人 |
| 公司/個人簡介 | (※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) |
| 公司/個人網址 | (※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) |
| 設計領域學經歷 | (個人申請者填寫) |
| 業界年資 | □1年以下 □1~5年 □5~10年 □10年以上 |
| 產品設計服務(※審查通過後將公開予產業瀏覽之資訊) |
| 專業設計領域 | □機構設計 □外型設計 □UI/UX設計 □平面設計 □其他  |
| 擅長產品設計類型 | □生活用品 □電子產品 □傢俱類 □家電用品 □玩具/人機介面 □設備儀器 □其他  |
| 曾執行之產品設計專案 |  |
| 獲獎歷績 |  |

**附件2：智造設計服務團參團同意書**

茲為 年度 (請填寫企業名稱/個人姓名)　 申請加入經濟部工業局產學研生態鏈結物聯網智造基地計畫所籌辦之智造設計服務團，結合跨界能量，共同奠定國內軟硬整合發展基礎，彌補創新產品開發階段之機構/外型設計之缺口，並加速軟硬整合產品達到可量產程度之進程，同意加入智造設計服務團，共計＿＿＿名設計師成員，並參與由執行單位財團法人資訊工業策進會所舉辦之相關產業活動，以玆證明。

**企業名稱/個人姓名：**

請填寫企業名稱並加蓋公司大小章/個人簽名並蓋印

中華民國　年　 月　 日

**附件3：蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

**經濟部工業局**

**蒐集個人資料告知事項暨個人資料提供同意書**

版本：P-CV19021141-DSI

**經濟部工業局（下稱本局）**為遵守個人資料保護法令及本局個人資料保護政策、規章，於向您蒐集個人資料前，依法向您告知下列事項，敬請詳閱。

1. 蒐集目的及類別

本局因辦理或執行產學研生態鏈結物聯網智造基地計畫之業務、活動、計畫、提供服務及供本局用於內部行政管理、陳報主管機關或其他合於本局組織規章所定業務、寄送本局或產業相關活動訊息之蒐集目的，而需獲取您下列個人資料類別：姓名、聯絡方式(如電話號碼、職稱、電子信箱、居住或工作地址等)、身分證統一編號，或其他得以直接或間接識別您個人之資料。

1. 個人資料利用之期間、地區、對象及方式

除涉及國際業務或活動外，您的個人資料僅供本局於中華民國領域、在前述蒐集目的之必要範圍內，以合理方式利用至蒐集目的消失為止。

1. 當事人權利

您可依前述業務、活動所定規則，以電子郵件之方式（崔小姐，nicolechtsui@iii.org.tw）向本局行使下列權利：

1. 查詢或請求閱覽。
2. 請求製給複製本。
3. 請求補充或更正。
4. 請求停止蒐集、處理及利用
5. 請求刪除您的個人資料。
6. 不提供個人資料之權益影響

若您未提供正確或不提供個人資料，本局將無法為您提供蒐集目的之相關服務。

1. 您瞭解此一同意書符合個人資料保護法及相關法規之要求，且同意本局留存此同意書，供日後取出查驗。

**個人資料之同意提供：**

一、本人已充分獲知且已瞭解上述經濟部工業局告知事項。

1. 本人同意經濟部工業局於所列蒐集目的之必要範圍內，蒐集、處理及利用本人之個人資料。

立同意書人：

中華民國 年 月 日

**附件4：智造設計服務團保密切結書**

立約人同意就雙方因進行物聯網智造基地之合作案（下稱「合作案」），所持有或知悉他方之機密資訊，約定保密事項及保密義務如下：

1. 本切結書所稱「機密資訊」，係指揭露方(物聯網智造基地團隊，下稱「揭露方」)交付收受方(智造設計服務團，下稱「收受方」)並註明為機密或其他同義文字之有形資訊，或揭露方以口頭方式向收受方揭露且於揭露時聲明其為機密，並於嗣後以書面追認其為機密之資訊。
2. 收受方對於下列資訊，不負保密責任：

（一）收受方於參加物聯網智造基地相關輔導活動前已為其合法持有或知悉之資訊。

（二）收受方自無保密義務之第三人合法取得或知悉之資訊。

（三）非因收受方之故意或過失而公開或為眾所周知之資訊。

（四）收受方（包括但不限於其員工、顧問或合作廠商）未使用任何機密資訊而自行研發或發現之資訊。

1. 保密義務

（一）收受方應盡善良管理人之注意義務，保管揭露方所揭露之機密資訊。未經揭露方事前書面同意，不得以任何方式直接或間接交付或洩漏機密資訊予第三人，且不得為超出合作案目的範圍利用或使用機密資訊。

（二）收受方應負責使其員工遵守本契約之保密義務。

（三）收受方因進行合作案而有揭露機密資訊予第三人之必要時，應事前取得該第三人同意依本契約約定保守機密資訊之書面承諾並經揭露方書面同意，收受方並就該第三人承諾負連帶履行之義務。若該第三人違反保密義務，視為收受方之違反，收受方應依本契約第五條之規定，對揭露方負損害賠償責任。

（四）收受方依法院或主管機關之命令而須揭露機密資訊時，應於收到該命令後立即通知揭露方，並配合揭露方採取合理必要之保密措施。

（五）本條保密義務之有效期間自揭露方向收受方揭露機密資訊時起算2年，不受本契約有效期間屆滿之影響。

1. 揭露方向收受方揭露之機密資訊，其所有權、專利權、著作權、營業秘密或技術秘竅（KNOW-HOW）係揭露方或其原授權人所有，不因揭露方揭露予收受方而生任何讓與、授權或權利設定之效力，收受方不得據以自行實施或申請專利權、著作權或其他智慧財產權，或使第三人行使上述權利。
2. 收受方如有違反本契約任何條款，揭露方得隨時要求收受方返還或銷毀機密資訊及其所有之重製物外，如另受有損害，並得請求收受方賠償之。
3. 收受方如發現第三人未經授權而違法使用機密資訊，應立即通知揭露方，並配合揭露方採取必要之排除或防止措施。
4. 本切結書自簽署日起生效，有效期間至合作案終止或完成時止。

立同意書人：

中華民國 年 月 日